

[IT EXPO 2011 현장] 나노멤, 다공질 세라믹 진공 흡착판 '에어로픽스'

[김태현 2011-09-26]



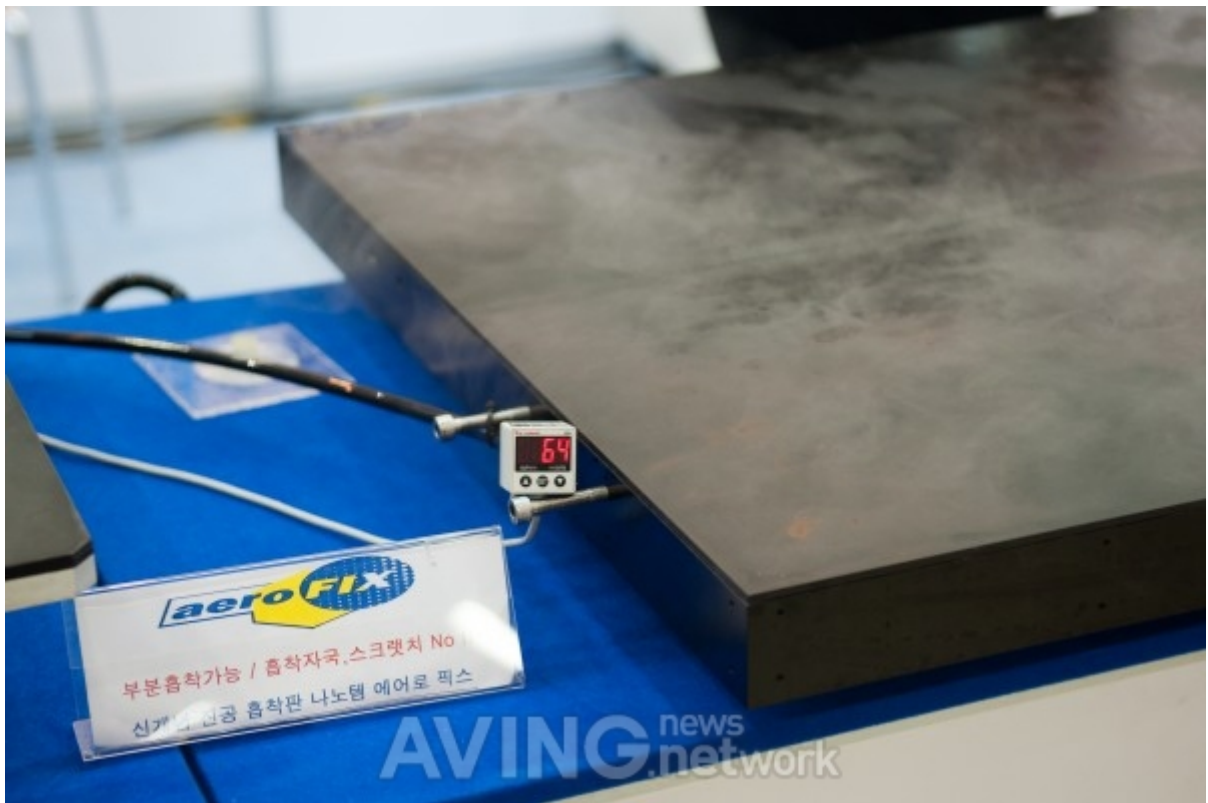
나노멤(대표 정재승, www.ki-mei.com)이 9월 26일부터 28일까지 경북 구미컨벤션센터 구미코에서 열리는 '2011 국제전자엑스포(IT EXPO 2011)'에 참가해 진공 흡착판 '에어로픽스(aeroFIX)'를 전시했다.

에어로픽스는 워크 사이즈에 관계없이 하나의 제품으로 모든 워크 사이즈에 흡착 대응이 가능한 다공질 세라믹 진공 흡착판이다. 워크의 종류, 용도에 따라 기공 사이즈와 기공율을 자유자재로 제어해 최적 조건으로 대응한다.

또한 특수소결제로 제품을 완전 소결시켜 자체 분진, 파티클 발생이 없으며, 흡착판의 대전방지 처리로 워크의 정전기를 자체적으로 해결한다. 흡착판 전면에 균일한 기공 배치로 워크의 전면을 흡착, 박막 필름 및 필름의 결부분 등을 전면 흡착할 수 있다.

한편, 국제전자엑스포(www.itexpo.kr)는 올해 첫 회로, 구미코(GumiCo) 전 층에서 88개사 151개 부스의 규모로 진행되며, 이번 전시회에서는 디지털 가전에서부터 전자장비, IT융합, 통신방송, SW&콘텐츠&솔루션, 자동화시스템, 공장제어기기, 부품소재까지 다양한 제품이 소개된다.


['2011 국제전자엑스포' 기사 보러가기](#)





Global News Network 'AVING'
(www.aving.net)

Copyright 2014 NSBS Corporation All rights reserved.

 출력하기 닫기